

2023年3月期
決算説明会資料

2023年5月18日



■ 業績報告

2023年3月期実績
2024年3月期予想

■ 中期経営計画

2023年3月期～
2027年3月期

2023年3月期 業績及び今期予想

(単位：億円)

	2022年3月期 通期実績	2023年3月期 通期実績	前期比	2024年3月期 通期予想	前期比
売上高	1,513	1,673	10.6%	1,650	-1.4%
営業利益	133 8.8%	96 5.7%	-27.8%	90 5.5%	-6.0%
経常利益	143 9.5%	112 6.7%	-21.6%	80 4.8%	-28.7%
当期純利益	115 7.6%	88 5.3%	-22.7%	62 3.8%	-29.9%
期中平均為替レート (JPY/USD)	113	136		130	

E B I T D A	213	193		191	
有利子負債	664	753		782	
自己資本比率	34.7%	38.2%		38.9%	
D / E レシオ	1.13	0.90		0.90	
R O E	19.5%	10.5%		7.0%	
R O I C	10.8%	5.9%		5.2%	

2023年3月期 商品別業績及び今期予想

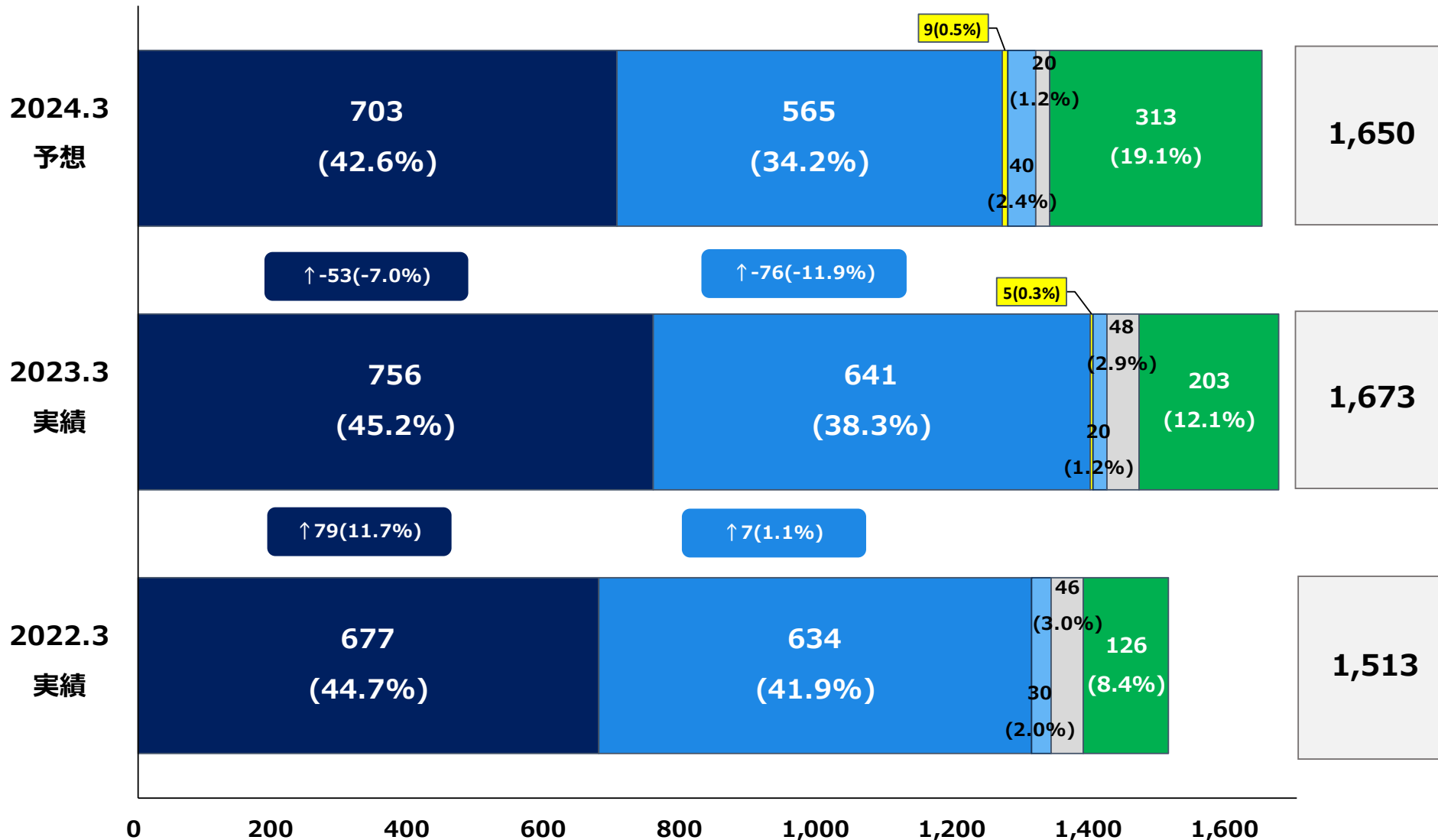
(単位：億円)

	2022年3月期通期実績		2023年3月期通期実績		2024年3月期通期予想	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
		営業利益率		営業利益率		営業利益率
車載	732	63 8.6%	845	60 7.1%	815	46 5.6%
スマートフォン タブレット	332	39 11.7%	271	11 4.1%	211	14 6.6%
半導体パッケージ		-	5	0 0.0%	9	-7 -77.8%
SSD IoTモジュール	68	11 16.2%	100	10 10.0%	89	13 14.6%
AI家電 アミューズメント 産機他商品	255	17 6.7%	249	16 6.4%	213	14 6.6%
EMS 電子機器開発製造	126	3 2.4%	203	-1 -0.5%	313	10 3.2%
合計	1,513	133 8.8%	1,673	96 5.7%	1,650	90 5.5%

仕様別売上高シェア

(単位：億円)

■ 多層貫通基板
 ■ ビルドアップ基板
 ■ 半導体パッケージ基板
 ■ リジットフレキ/フレキ基板
 ■ 放熱/大電流/他基板
 ■ EMS/電子機器開発製造



■ 業績報告

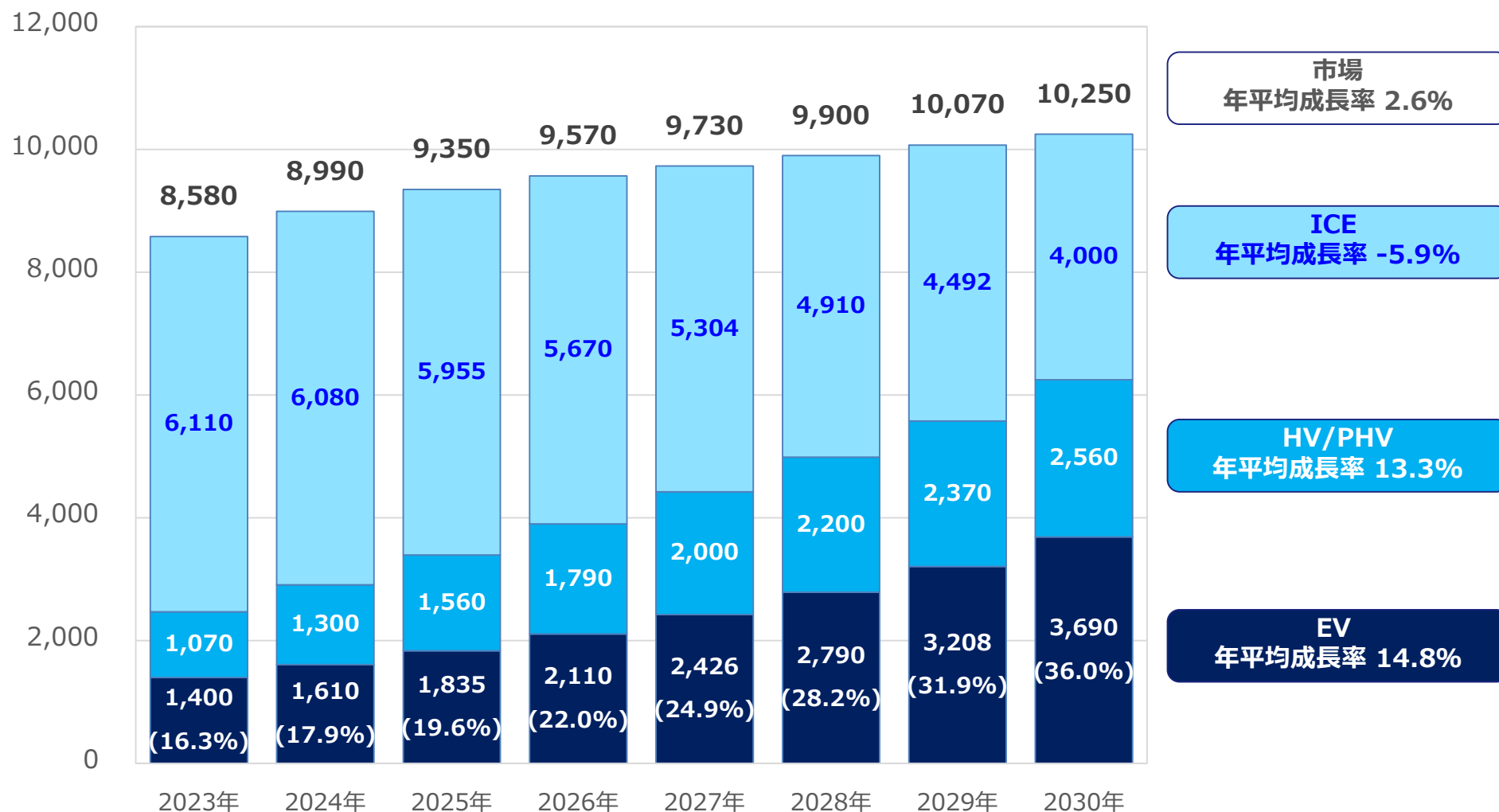
2023年3月期実績
2024年3月期予想

■ 中期経営計画

2023年3月期～
2027年3月期

市場予測 自動車

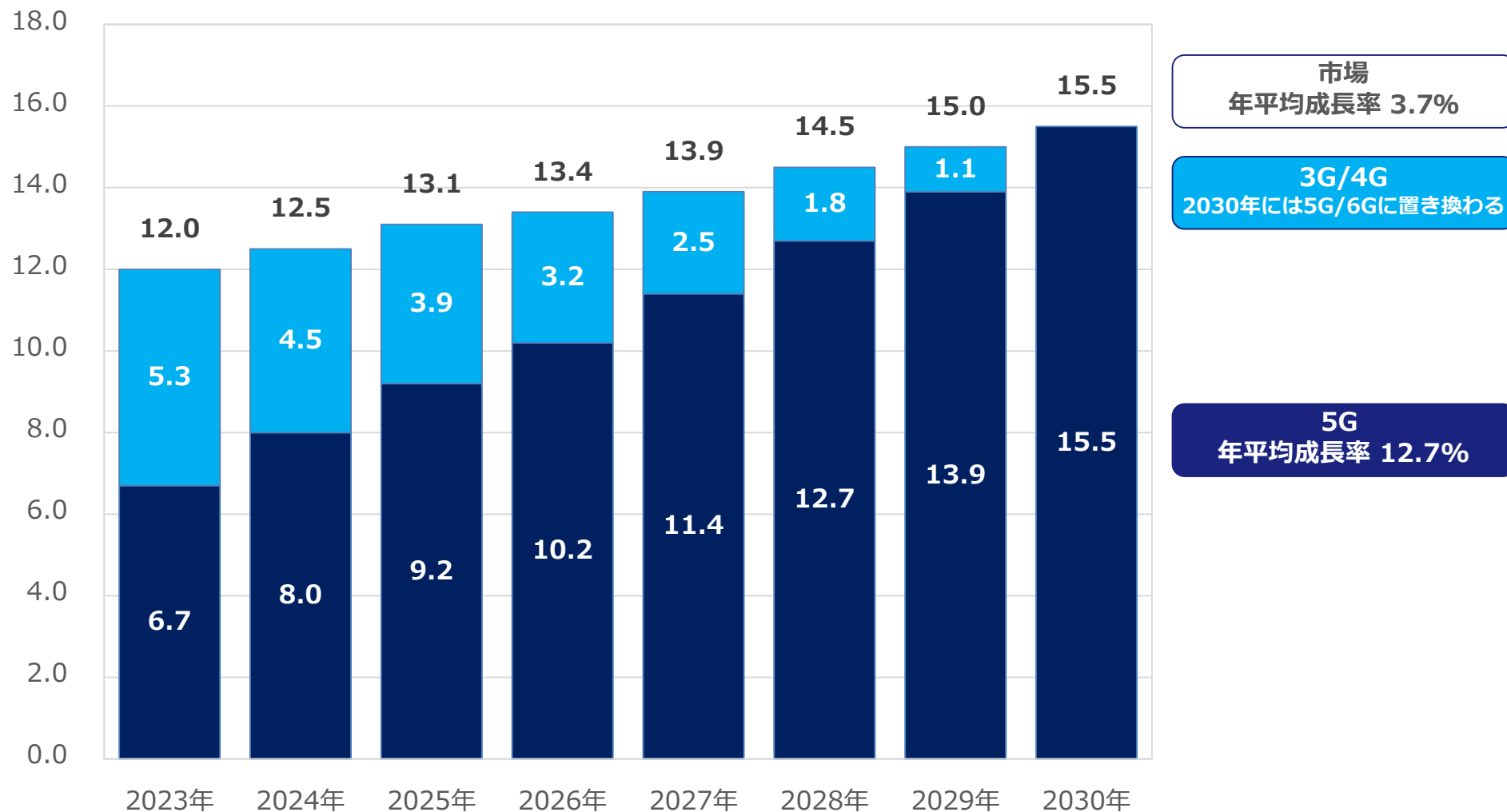
(単位：万台)



*IEA,調査会社のデータに基づき当社が予想

市場予測 スマートフォン

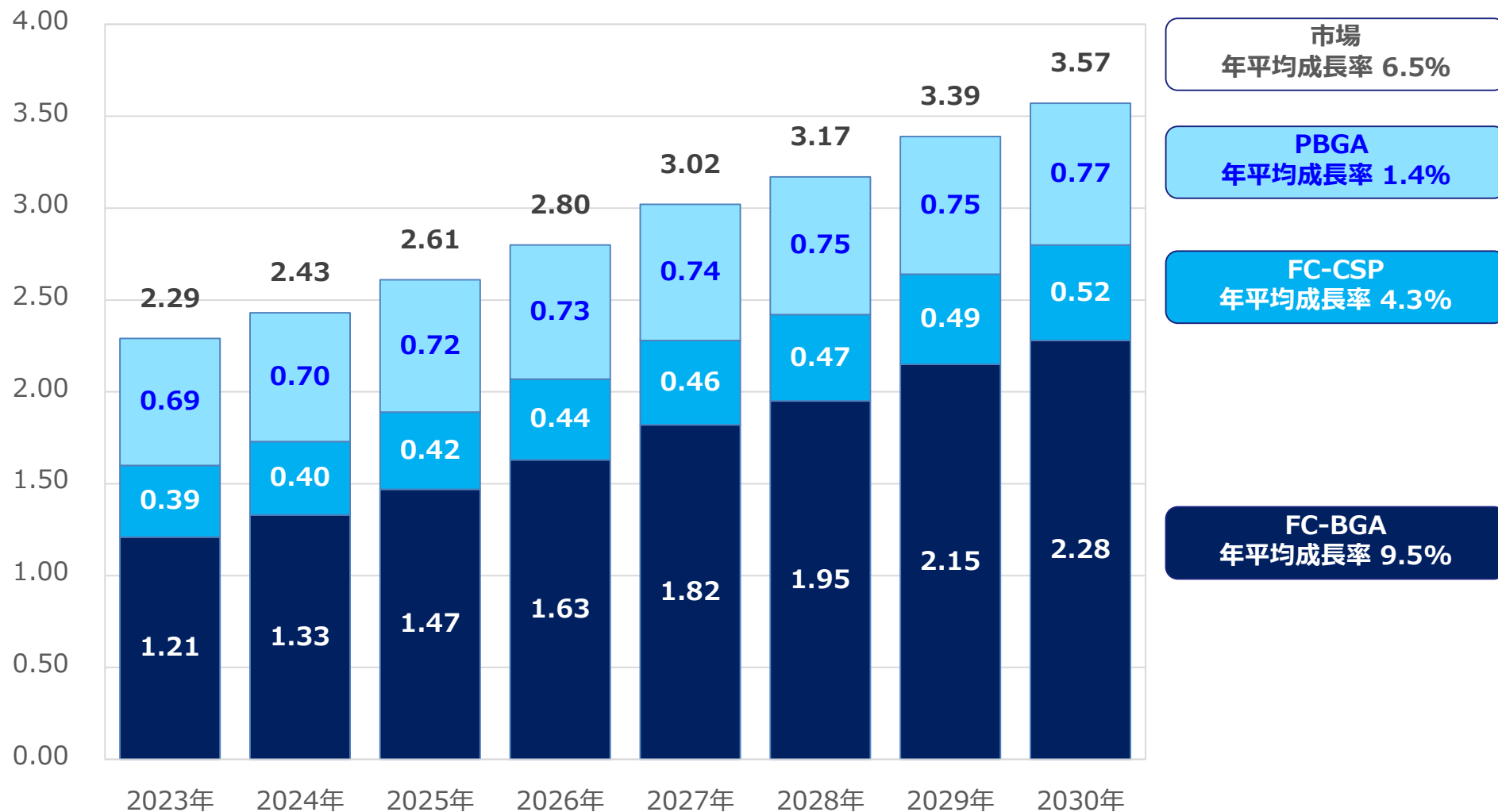
(単位：億台)



*調査会社のデータに基づき当社が予想

市場予測 半導体パッケージ基板

(単位：兆円)



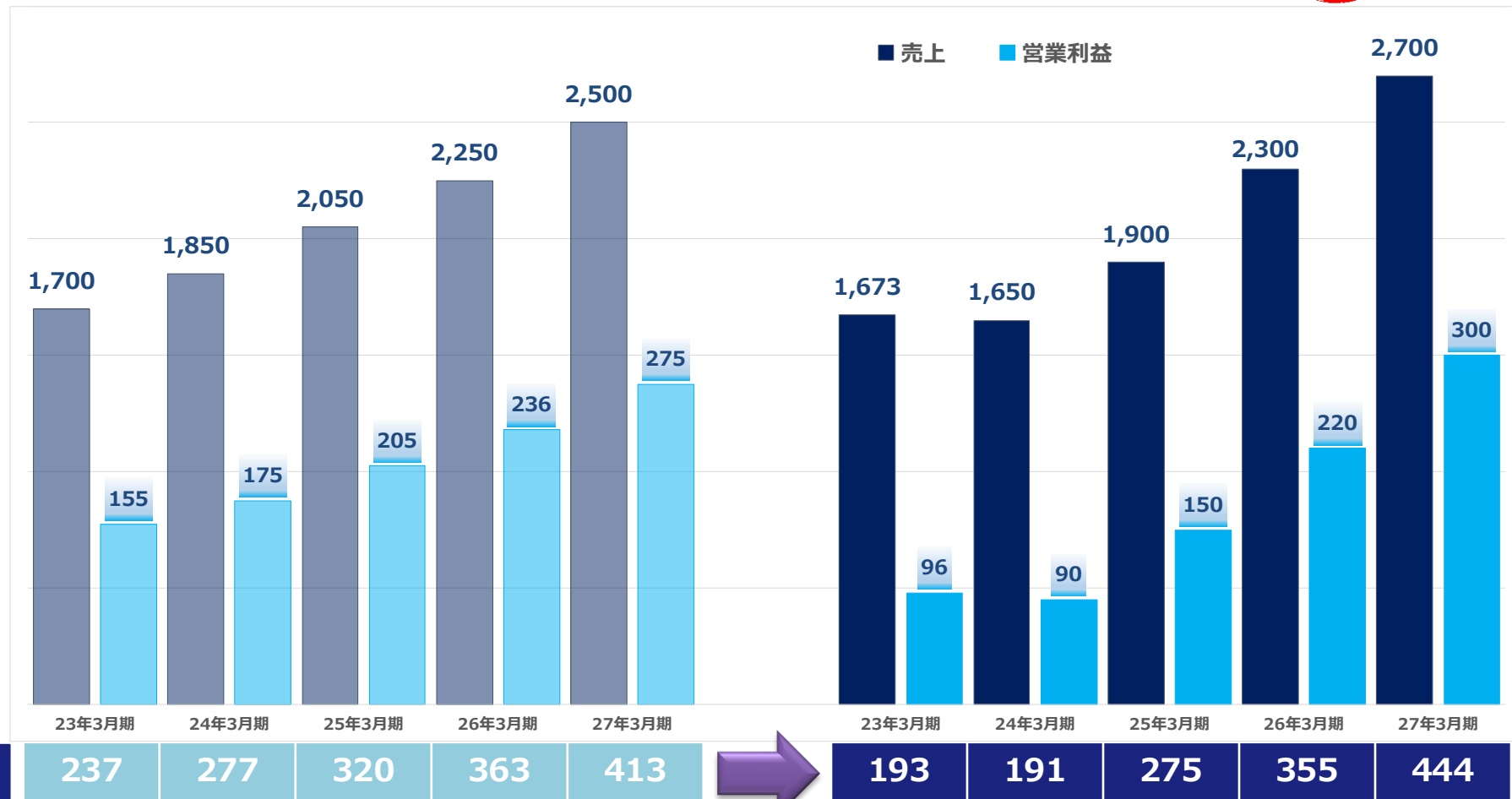
*調査会社のデータに基づき当社が予想

中期経営計画 概要

(単位：億円)

2022年5月公表計画
23.3-27.3 売上年平均成長率 10.1%

修正計画
23.3-27.3 売上年平均成長率 12.7%

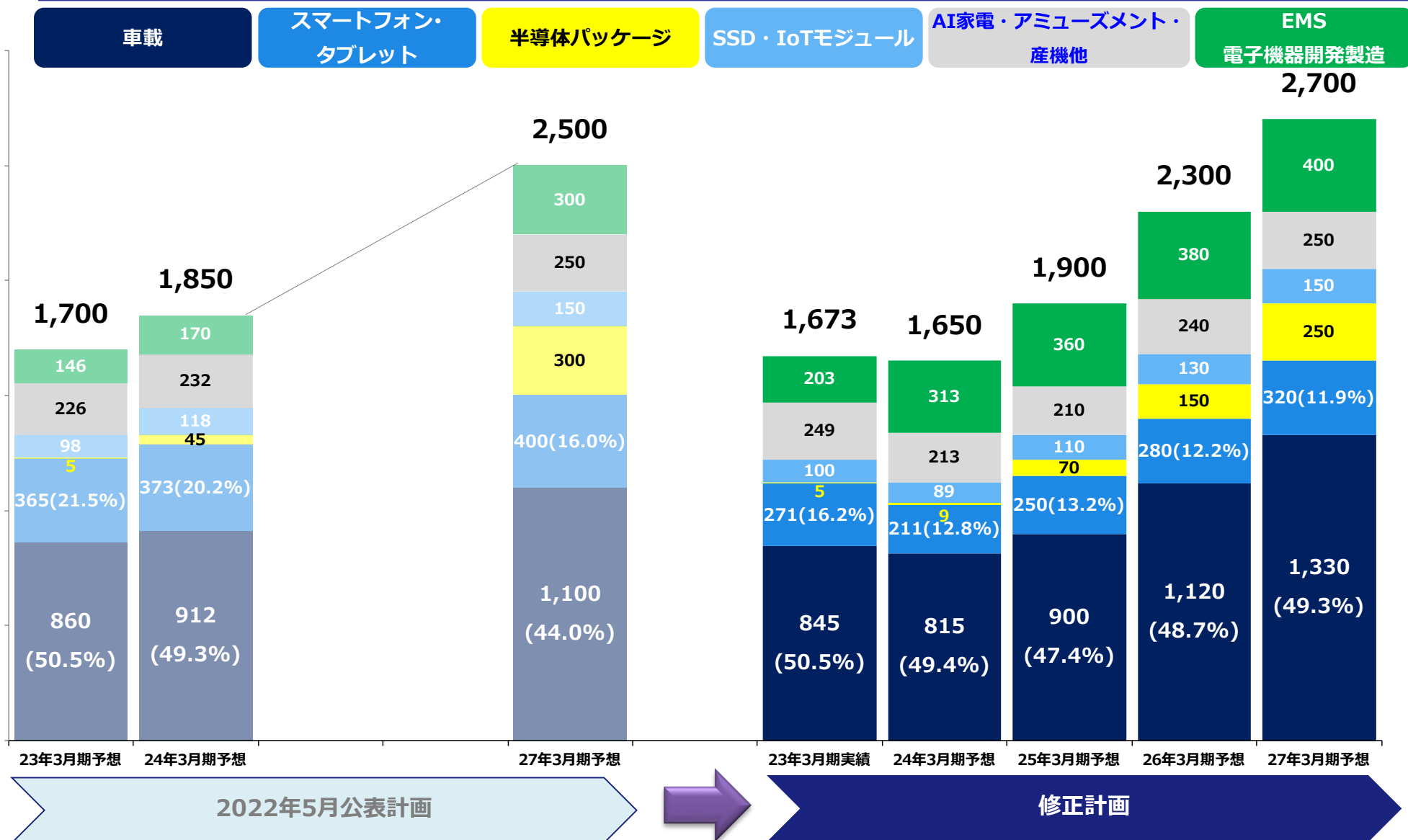


2023.3-2027.3 投資合計 1,000億円

2023.3-2027.3 投資合計 900億円

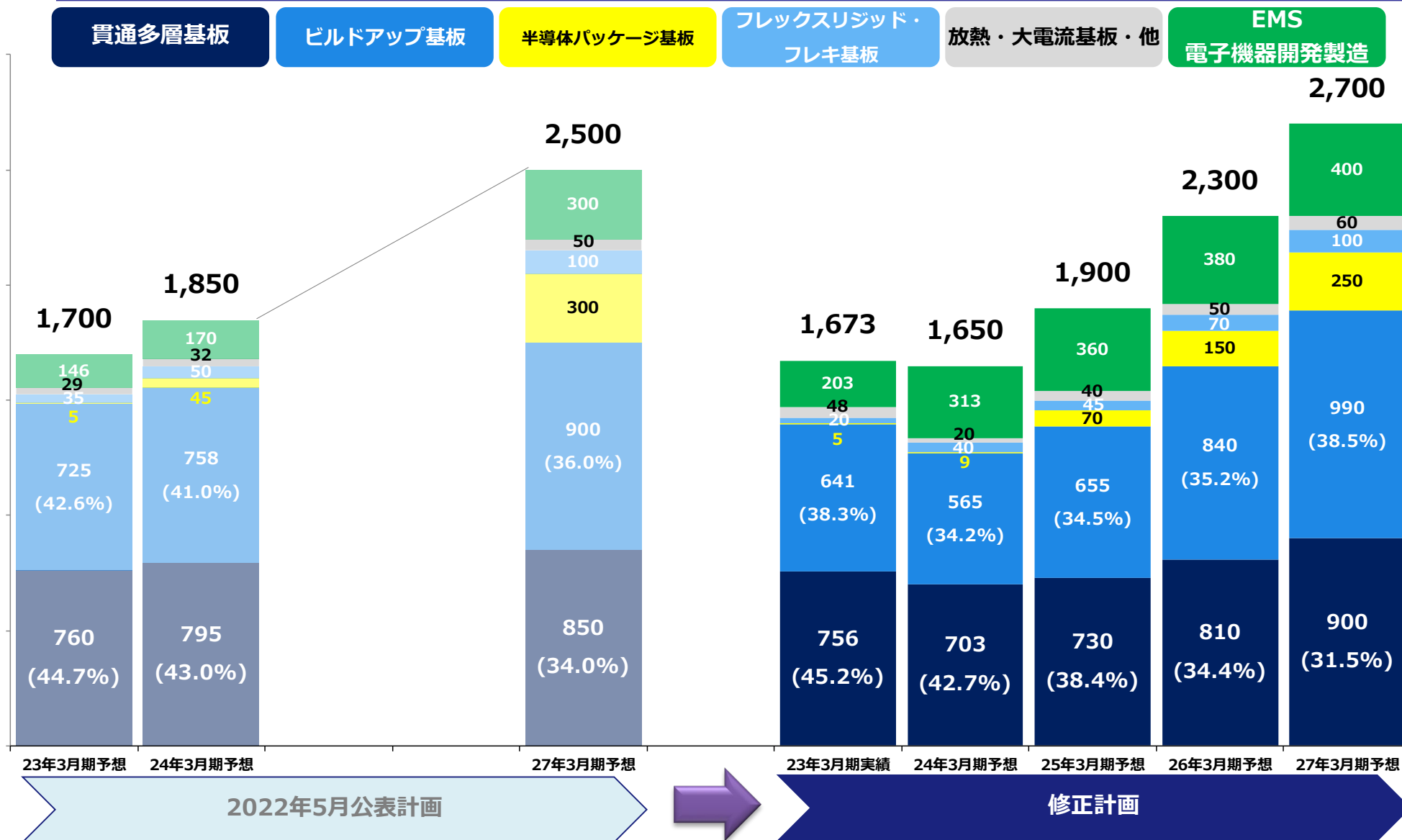
中期経営計画 商品別売上推移

(単位：億円)



中期経営計画 仕様別売上推移

(単位：億円)



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。